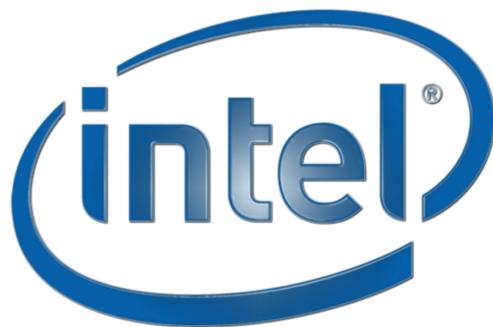
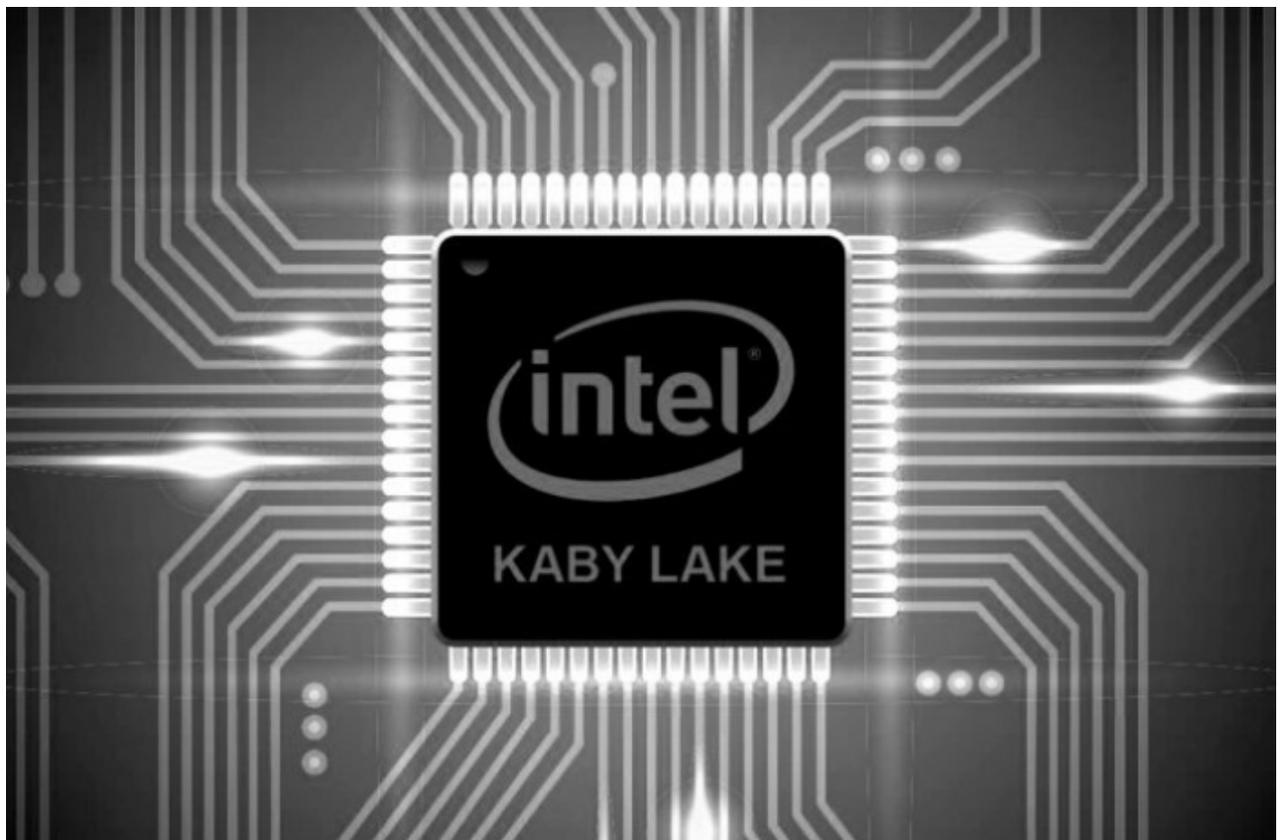


Svelate le principali specifiche di Z270 e H270



LINK (<https://www.nexthardware.com/news/processor-chipset/7835/svelate-le-principali-specifiche-di-z270-e-h270.htm>)

Publicati in rete ulteriori dettagli sui nuovi chipset Intel per Kaby Lake.



Nel mese di gennaio debutteranno le nuove CPU Kaby Lake di Intel in abbinamento ai nuovi chipset della serie 200, ma quali sono le differenze principali tra questi ultimi e quelli appartenenti alla serie 100?

In attesa che Intel rilasci ufficialmente le specifiche complete della prossima generazione di chipset mainstream, ci vengono in aiuto i soliti bene informati ragazzi di [BenchLife \(https://benchlife.info/intel-z270-h270-q270-q250-b250-z170-h170-chipset-11202016/\)](https://benchlife.info/intel-z270-h270-q270-q250-b250-z170-h170-chipset-11202016/) che hanno pubblicato nuove informazioni riguardanti proprio tali differenze, almeno per quanto concerne Z270 e H270.

Incominciamo con il ribadire che anche la serie 100 supporterà le nuove CPU Kaby Lake tramite un aggiornamento dei BIOS delle mainboard, ma i nuovi chipset, come è ormai noto, saranno compatibili con la futura serie di SSD Intel con tecnologia Optane (3D XPoint), capaci di prestazioni decisamente superiori a tutto ciò che attualmente è disponibile sul mercato consumer rappresentando, senza dubbio, la novità di maggior rilievo.

Chipset	Z270	Z170	H270	H170
Support	Kaby Lake-S (7th Gen) / Skylake-S (6th Gen)			
CPU PCIe Configuration	1 x 16 or 2 x 8 or 1 x 8 + 2 x 4		1 x 16	
Independent DisplayPort	3			
Memory DIMMs	4			
Overclocking	Yes		No	
Intel SmartSound Technology	Yes			
Intel Optane Technology	Yes	No	Yes	No
Intel Rapid Storage Technology	15	14	15	14
Intel Rapid Storage Technology from	Yes			
RAID 0?1?5?10	Yes			
Intel Smart Response Technology	Yes			
I/O Port Flexibility	Yes			
Maximum High Speed I/O?HSIO?Lanes	30	26	30	22
Total USB Ports?Max USB 3.0?	14 (10)		14 (8)	
Max SATA 6.0Gbps Ports	6			
Max PCIe Express 3.0 Lanes	24	20		16
Max Intel RST for PCIe Storage Ports	3		2	
BenchLife.info				

L'altra cosa interessante, come si evince dalla tabella in alto, è il numero maggiore di linee PCI-E "a valle" dei chipset serie 200 rispetto alla precedente generazione, 14 contro 10, il che significa che i progettisti di schede potranno spingere maggiormente sulla presenza di controller Thunderbolt e USB 3.1, slot M.2 aggiuntivi o, semplicemente, slot PCI-E con una larghezza di banda superiore ai canonici X1, con un ribilanciamento complessivo di tutte le linee disponibili che sale a 30 per le nuove piattaforme.↔